

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-027

## **方正科技集团股份有限公司**

### **关于对控股子公司提供担保的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人：珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公司、IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.（中文名称“爱方智造（泰国）有限公司”），上述被担保人均均为方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）下属控股子公司，不存在关联担保。
- 新增担保金额：自上个披露日（2024年6月1日）至本公告披露日，公司为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为25,000万元；公司为被担保人重庆方正高密电子有限公司提供的融资担保金额为10,000万元；公司为被担保人IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.提供的融资担保金额为70,000万元；新增提供的融资担保合计105,000万元。
- 担保总额：截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计为305,000万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

公司分别于2024年3月28日、2024年4月22日召开公司第十三届董事会2024年第一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，同意公司对各控股子公司提供不超过38亿元额度的担保。担保额度的有效期为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司各控股子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《方正科技集团股份有限公司关于2024年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2024-007）。现将担保进展公告如下：

### 一、新增担保情况概述

为满足控股子公司的经营发展需要，自上个披露日（2024年6月1日）至本公告披露日，公司为控股子公司新增提供的融资担保合计105,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	其中本次新增担保额度	是否关联担保	是否有反担保
方正科技	重庆方正高密电子有限公司	间接持股100%	29.58%	44,000	10,000	否	否
方正科技	珠海方正科技高密电子有限公司	间接持股100%	40.44%	113,500	25,000	否	否
方正科技	I FOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.	间接持股100%	7.4%	70,000	70,000	否	否

## 二、被担保人基本情况

### 1、珠海方正科技高密电子有限公司

单位：人民币万元

企业名称	珠海方正科技高密电子有限公司	法定代表人	孙玉凯
注册资本	15,815.2228万美元	成立日期	2004年12月07日
社会信用代码	91440400769320863B	企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址	珠海市富山工业区虎山村口方正PCB产业园HDI厂房、HDI扩建厂房及QTA厂房		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)	
资产总额	269,626.90	261,960.98	
负债总额	120,921.14	105,928.15	
净资产	148,705.76	156,032.83	
资产负债率	44.85%	40.44%	
科目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)	
营业收入	146,439.71	77,251.12	
净利润	13,596.76	7,327.06	

### 2、重庆方正高密电子有限公司

单位：人民币万元

企业名称	重庆方正高密电子有限公司	法定代表人	孙玉凯
注册资本	8,745万美元	成立日期	2006年04月21日
社会信用代码	915000007874621363	企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址	重庆市沙坪坝区西永大道5号附1-9号		
主营业务	生产和销售电路板		

公司与被担保人关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。	
财务状况		
科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	115,497.91	111,397.72
负债总额	28,104.86	32,950.57
净资产	87,393.05	78,447.15
资产负债率	24.33%	29.58%
科目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	70,604.57	38,989.28
净利润	7,574.96	5,654.10

### 3、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.

单位：人民币万元

企业名称	IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.	公司董事	孙玉凯、王喆
注册资本	113,700万泰铢	成立日期	2023年10月2日
注册号码	0255566002232	企业类型	有限责任公司
注册地址	No.141, Moo.12, HuaWa Sub-District , Si Maha Phot District, Prachinburi Province 25140, Thailand		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)	
资产总额	1,013.42	11,870.89	
负债总额	1.89	878.26	
净资产	1,011.53	10,992.63	
资产负债率	0.19%	7.4%	
科目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)	
营业收入	0.00	0.00	

净利润	-2.09	-35.62
-----	-------	--------

其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

### 三、担保协议的主要内容

上述公司新增提供的担保，均为公司为满足控股子公司生产经营需要融资事项提供的担保，均按法定程序签署担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际需要与债权人协商确定。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保方	存在的关系	债权人	担保金额	贷款期限（月）	担保方式
方正科技	重庆方正高密电子有限公司	公司间接持有其100%股权	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	10,000	12	方正科技连带责任保证担保
	珠海方正科技高密电子有限公司	公司间接持有其100%股权	中国进出口银行广东省分行	20,000	36	
			中国银行股份有限公司珠海分行	5,000	7	
	IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.	公司间接持有其100%股权	国家开发银行广东省分行	70,000	96	方正科技连带责任保证担保、项目资产抵押担保

### 四、担保的必要性和合理性

上述新增担保事项系为满足公司控股子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对

公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

## 五、担保的审批程序

公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 22 日召开公司第十三届董事会 2024 年第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，同意公司对各控股子公司提供不超过 38 亿元额度的担保。担保额度的有效期为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保均在 2023 年年度股东大会批准的额度范围内，根据公司 2023 年年度股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司提供的担保总额为 305,000 万元（含上述新增担保），占公司最近一期经审计净资产的 79.23%，均为公司对控股子公司的担保；公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日